

2005 年 12 月 1 日

エルピーダメモリ株式会社  
広島エルピーダメモリ株式会社

## 広島エルピーダ 300mm 増設ライン竣工式開催

E300 ファブ月産 54,000 枚化に向けて能力増強進行中



エルピーダメモリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO 坂本幸雄、以下、エルピーダ）および広島エルピーダメモリ株式会社（本社：広島県東広島市、代表取締役社長：大塚周一、以下、広島エルピーダ）は、本日、広島県および東広島市などの関係者をお迎えし、広島エルピーダ 300mm ウェハ増設ラインの竣工式を行いました。

式においては、エルピーダが今年 10 月に発表した生産能力増強計画が極めて順調に推移していることを報告しました。

広島エルピーダでは、昨年 6 月に着工した増設ライン建屋を今年 6 月に予定どおり完成させ、その後、クリーンルーム設置、設備導入、試作を行ってまいりました。

その結果、去る 10 月 17 日に本増設ラインへ量産第一ロットを投入、DRAM 業界における量産の最先端プロセスである 90nm プロセスを用いて生産を開始し、現在まで順調に稼働するとともに、さらに、計画どおり日々投入枚数を拡大しています。

この300mm ウェハライン(以下、E300 ファブ)の生産能力は、本年度第1四半期平均では月産30,000枚でしたが、第1～第2四半期を通して行った生産性の改善および急ピッチでの増設ライン立上げにより、すでに11月にはE300 ファブ合計で45,000枚の投入を実現、さらに12月には月産50,000枚の投入を見込んでおります。加えて、今年度第4四半期には国内最大規模である月産54,000枚まで拡大できる見通しです。

また、量産プロセスとして最先端である90nm プロセスによる生産についても、今年10月発表のとおり、今年度中にはE300 ファブにおける月産総数の約70%まで引き上げること計画しています。この90nm プロセスでの生産歩留まりは、量産開始当初から非常に良好に立ち上がってきております。

今回の順調に推移している能力増強が本格的に出荷に寄与するのは、本年度第4四半期以降ですが、投入枚数の増加と90nm プロセスへの移行の相乗効果により、来年度上期の出荷量は現在に比して飛躍的に拡大いたします。このことが、当社の利益および当社製品の市場への安定供給へ大きく貢献すると見込んでおり、これにより世界No.1のDRAMカンパニーという目標に向かって着実に前進していくことが期待されます。

広島エルピーダ 300mm ウェハラインの概要は、別紙をご参照ください。

(注)生産能力は、300mm ウェハの処理枚数で表記しています。

以 上

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

【別紙】

**広島エルピーダメモリ 300mm ウェハラインの概要**

構築場所：広島エルピーダメモリ株式会社 敷地内

増設ライン工事着工：2004年6月

増設ライン建屋完成：2005年6月

増設ライン量産開始：2005年10月

処理能力：45,000枚/月(2005年11月時点)、54,000枚/月(2005年度第4四半期予定)

発注者：広島エルピーダメモリ株式会社

設計・施工者：株式会社大林組